

武汉金运激光股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月22日以电子邮件、当面送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第五次会议通知，会议于2019年1月28日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，其中独立董事2人。会议由董事长梁萍女士主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《关于公司与关联方合作建房的议案》

由于公司主要生产基地一直采取租赁方式取得且分别位于武汉的三个不同区域，而公司部分生产管理人员和销售人员在公司所属办公总部工作，致使人员场所分散，不利于管理高效且增加了管理成本；加之，厂房租赁费用较高，且续租和租金上涨水平均存在较大的不确定性，是公司保持生产经营持续稳定的一个潜在问题亟待解决，则公司在综合考虑现有经营规模、资金状况以及经营扩展规划等多方面因素基础上，拟与关联法人武汉金运云智能网络有限公司（以下简称“金运云”）合作建房，即由公司在金运云拥有国有建设用地使用权的土地上建造适合实际需求的厂房，将降低相关成本费用且基本解决上述现存的问题。

公司与金运云经友好协商，本着市场化原则，签署了《合作建房协

议》：金运云将宗地中 12,200.23 平方米的宗地面积用于公司自建厂房，建筑面积 14,305.92 平方米，建造预算不超过人民币 1,200 万元。

因金运云系公司控股股东及实际控制人梁伟先生控制的公司，为公司关联法人；董事梁萍、肖璇均为梁伟先生的关联人，则该事项属于关联交易，且关联董事梁萍、肖璇回避了对本议案的表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司独立董事已发表同意意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

2、审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

根据公司经营资金的总体安排考虑，公司拟采取外币质押方式向银行申请不超过人民币 2,500 万元的贷款。

具体合作银行以及最终融资金额（包括该额度项下的具体贷款额度、贷款期限、利率、费率等条件及和质押有关的其他条件）后续进一步协商后确定，相关融资事项以正式签署的协议为准。

公司视经营需要在贷款额度内进行融资，公司董事会不再逐笔形成决议。

公司董事会授权董事长签署上述贷款额度内的各项法律文件。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

《公司关于与关联方合作建房关联交易的公告》、《公司关于向银行申请贷款的公告》（公告编号 2019-002、2019-003）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2019 年 1 月 29 日